

展示No	区分	□部品 □素材/材料 □設備/装置 □金型/治工具 □システム/ソフトウェア ■その他(受託サービス)	
35-2	提案名	半導体の開発から解析までワンストップ対応	
会社名	(株)デンケン	所在地	大分県杵築市守江1300番地
連絡先	部署名 : エレクトロニクス事業部 営業企画課 担当名 : 内藤 彩花	URL	: https://www.dkn.co.jp/
主要取引先	・ソニー(株) ・三菱電機(株)	E-mail	: saika.naito@dkn.co.jp
海外対応	・(株)デンソー	生産拠点国を記入	□ 可 [] ■ 否

<< 提案内容 >>

提案の狙い	適用可能な製品/分野
□ 原価低減	□ 品質/性能向上
□ 質量低減	□ 安全/環境対策
■ 生産(作業)性向上	□ その他()
従来	新技術・新工法
複数社への委託検討依頼が必要で 窓口工数増 <p>カスタムICを検討したい MCMなど部品実装 半導体開発・量産組立をしたい ICがEOLになってしまった 単一工程の評価をしたい</p>	委託窓口を一本化 半導体の開発から解析まで、すべて対応 <p>LSI設計 パッケージ試作 信頼性試験 電気特性評価 パッケージ量産/検査 解析</p> <p>LSI設計: アナログ回路設計、カスタムIC作成、EOL、PCN対応、材料評価 パッケージ試作: 単独工程での材料評価が可能、レガシー半導体パッケージからFCBGAなど先端半導体パッケージまで対応 信頼性試験 電気特性評価: 信頼性試験、ESD試験、電気特性評価、テスト環境の構築、パワーサイクル試験 パッケージ量産/検査: パッケージ試作/量産(信頼性評価後)を実現します、量産パッケージにおける品質保証体制を確立 解析: 故障解析フロー (X-ray/SAT, 電気的特性, I-V特性, パッケージ剥離, チップ剥離/EMISSION, FIB断面解析) 問題点(課題)と対応方法 リソースの偏り・ボトルネック発生 工程負荷の可視化、多能工化、外部連携により改善</p>
セールスポイント(製造可能な精度/材質等)	問題点(課題)と対応方法
<ul style="list-style-type: none"> 半導体の開発から解析まで1社でコントロール可能 窓口工数の低減 工程間の連携により、待ち時間や調整時間を最小化 開発期間の短縮 	<ul style="list-style-type: none"> リソースの偏り・ボトルネック発生 工程負荷の可視化、多能工化、外部連携により改善

開発進度	(2025年 10月 現在)				パテント有無
	□ アイデア, □ 試作/実験, □ 開発完了, ■ 製品化完了(採用: ■ 実績有, □ 予定有, □ 予定無)				無
従来との比較	項目	コスト	品質	生産性	その他()
	数値割合	-	-	30%向上	-